

# 禧合<sup>®</sup> 9306

## 半导体封装水基型助焊剂清洗剂

### 描述

禧合9306是一款专门研发应用于高中压在线或批量喷淋清洗系统中焊后助焊剂清洗的水基环保清洗剂。

9306同样适用于诸如超声、喷流、离心式等浸入式清洗系统，可有效去除电路板和半导体器件助焊剂残留，广泛应用于焊后电路板、组装电路板，以及引线框架、功率模块、分立式功率器件和摄像头模组芯片的清洗。

9306清洗过程在完美兼容电子器件敏感材料的同时，特别对于铜器件表面氧化物和其他油性污渍的清除具有非常优秀的表现，为后续的涂敷、底部填充、封装和邦线工艺提供最高的洁净度要求。

### 特点

- 特别适用于在线或者批量喷淋清洗系统，不起泡，易漂洗，不会在工件表面形成残留；
- 可有效清除各类功率器件铜表面的金属氧化物和其他污渍，并避免铜表面的再次氧化；
- 可有效清洗细小间距器件如 $\mu$ BGA/ Flip Chip 等，特别适用于无铅/免洗型焊膏的助焊剂残留清洗；
- 清洗后焊点光亮，对铝、镍和其他敏感金属材质完全兼容；
- 低应用浓度，高污物负载能力，使用寿命长，性价比高；
- 环境友好，不含ODS和卤素成分，低气味，对人体安全。

### 清洗标准

经禧合9306工艺清洗后的印制板组件能够达到以下工业洁净度标准：

- 1: IPC-A-610视觉检测
- 2: J-STD 001离子污染度测试
- 3: IPC-TM650表面绝缘阻抗测试
- 4: GJB- 5807 军工洁净度检测评估

### 安全信息

禧合9306是可生物降解水基型清洗剂，不含任何卤素和臭氧损耗的成分，对人体安全性良好，使用过程中无需特殊的防护措施。

属非危险化学品，HMIS分级为0-0-0，符合RoHS和WEEE规定，请参考MSDS以获得更多的建议信息。

### 应用

领域	污染物
印刷电路板/组装板	各种低固型助焊剂、 松香/树脂类助焊剂、 水溶性助焊剂等
厚膜器件/陶瓷基板	
功率模块/镜头模组	
分立器件/功率LED	
倒装芯片/BGA 器件	

### 产品参数

属性	单位	数值
外观	-	清澈液体
闪点	°C	无
pH 值	10g/L	10.2
表面张力	mN/m	27.2
沸程	°C	98~100
饱和蒸汽压【20°C】	mbar	21.2
水溶性	-	可溶
密度, 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1.00±0.02
清洗温度	°C	40~70
应用浓度	浓缩液%	10~30
	即用液%	100

数据基于15%浓度即用液

### 工艺及使用

工艺	清洗	漂洗	烘干
喷淋	禧合9306	去离子水	循环热风
超声波	禧合9306	去离子水	循环热风

### 包装

5L / 25L / 200L 浓缩液塑料桶包装。

### 储存&操作

请在5°C-30°C环境下保存。未开封的产品保质期为五年；使用时避免接触眼睛和皮肤。